

# 「新たな Nessum 技術のご紹介並びに Nessum 活用の最新動向について」

Nessumアライアンス  
会長代行 三宅 隆則



2024年5月10日

HD-PLCアライアンスは、2023年10月2日より、  
新名称「Nessum（ネッサム）アライアンス」として  
新たなステージに挑戦。

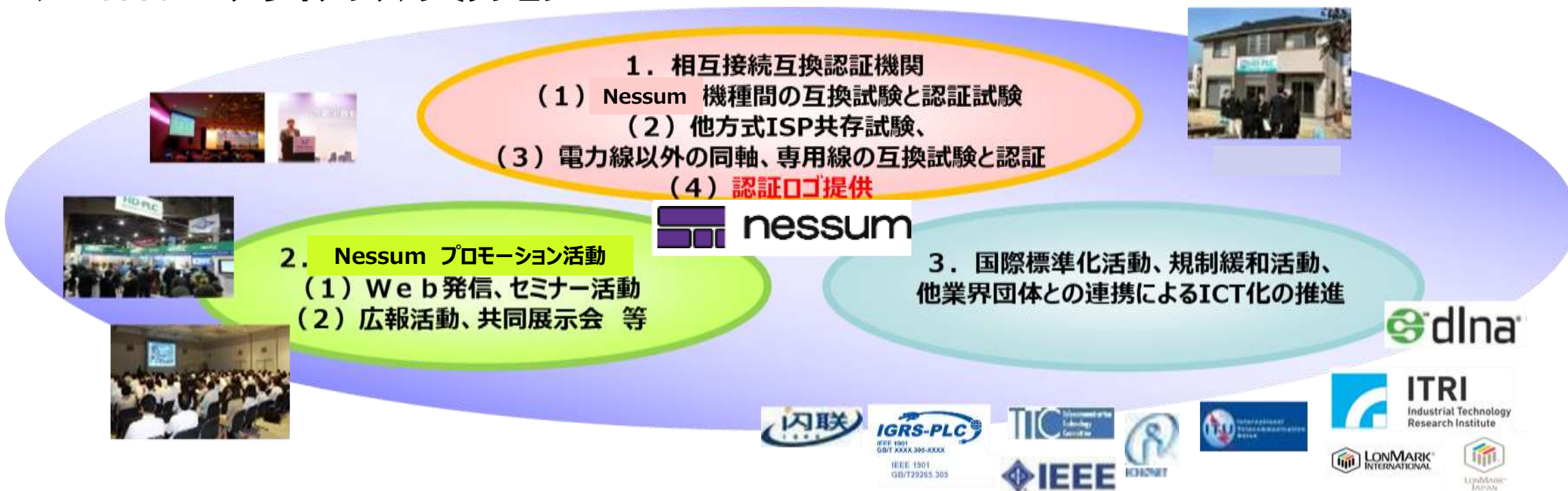


(17年間 ご愛顧ありがとうございました)

(ネッサム)

**Nessum通信技術 IEEE 1901-2020、1901cと共に互換性確保、国際標準規格の技術進化を促進、XIoT社会に貢献する新たなステージに移行します！**

## ◆ Nessum アライアンスのミッション



## Promoter 推進会員 (3社 3G)



パナソニックホールディングス  
株式会社  
Panasonic Holdings Corp.

Founder  
発起人



株式会社シキノハイテック  
Shikino High-Tech Co. Ltd.



東朋テクノロジー株式会社  
Toho Technology Corp.

## Standard 一般会員 (19社 19G)



Egretcom株式会社  
Egretcom Co.,Ltd



株式会社ユビキタスAI  
Ubiquitous AI Corporation



富士電機株式会社  
FUJI ELECTRIC CO.,LTD.



九州計測器株式会社  
Kyushu Keisokki Co., Ltd.



GE VERNOVA  
GE MDS LLC



Power Plus Communications AG



株式会社メガチップス  
MegaChips Corporation



株式会社ソシオネクスト  
Socionext Inc.



株式会社ミライト・ワン  
MIRAIT ONE Corporation



ミネベアミツミ株式会社  
MinebeaMitsumi Inc.



ヌリフレックスジャパン株式会社  
NURI Flex Japan Co.,Ltd.



Progilon Sarl.



埼玉エンジニアリング株式会社  
Saiko Engineering Co., Ltd.



Shanghai Clouder  
Semiconductor Co., Ltd.



Shanghai Produce Media  
System Co., Ltd.



株式会社ヘルヴェチア  
Helvetia Inc.



UL Solutions



コイト電工株式会社



Xngtera Inc.

## Supporter 賛助会員 (2社 2G)



Ecolinx Corporation



SASKEN

Sasken Technologies Ltd



Microchip Technology Inc.



LONMARK  
JAPAN

非営利活動法人  
LONMARK JAPAN  
NPO LONMARK JAPAN

## Associate Partner 協力パートナー



IEEE Standard Association



IGRS Engineering Lab Ltd.



Industrial Technology Research  
Institute



LonMark International



一般社団法人情報通信技術委員会  
Telecommunication Technology Committee

# Nessumアライアンス会員 商品群の一例 (第4世代の商品も充実中)

\* All photos and illustrations are for illustrative purposes only.

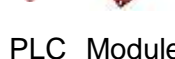
## Chips



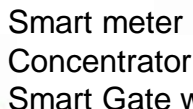
## SDKs and Evaluation



## Modules/ Adaptors



## Embedded Products



\* All photos and illustrations are for illustrative purposes only.

(Source: Nessum Alliance member companies)



2024年  
5月15日  
16:00-17:10  
Zoom

## Nessum アライアンスウェビナー (第11回)

「国内関係法令整備の最新状況と Nessum 運用方法解説、  
及びエネルギー管理分野における応用事例紹介」他

ご登録はお早めに

開催日時 2024年5月15日(木)16:00-17:10(日本時間)

参加料 無料(事前登録は、<https://jp.nessum.org//media/seminar/webinarj-11>より)

### ■ウェビナー概要

Nessumアライアンスは標準化、法整備やNessum WIRE設置に関する解説、またエネルギー管理分野における応用事例紹介などNessum技術について理解を深めていただくためのオンラインセミナーを開催いたします。

### 講演内容

【開場挨拶】 国際標準規格IEEE 1501c発行及びNessum採用事例のご紹介



三宅 隆則氏

Nessumアライアンス 会長

ホームページ: [Nessumアライアンス](#)

【講演1】 法整備とPLC-Jガイドライン最新状況、およびNessum WIRE設置に関する解説  
PLC-Jより実行速度に対する最新情報やPLC-Jのガイドラインについてご紹介します。



亀倉 俊幸氏

高度電力線通信技術協会(PLC-J) 技術専門委員会

ホームページ: [高度電力線通信技術協会\(PLC-J\)](#)

【講演2】 エネルギー管理分野におけるnessum技術の活用事例

総務省インフラの導入におけるPLC-Jシステムや、スマートビル・施設システムでのnessumの活用にて、貴社がデバイスや二層ネットワーク構築した実用事例をご紹介します。



鈴木 真幸氏

マリフレックスジャパン株式会社 代表取締役

ホームページ: [マリフレックスジャパン](#)

Q&A

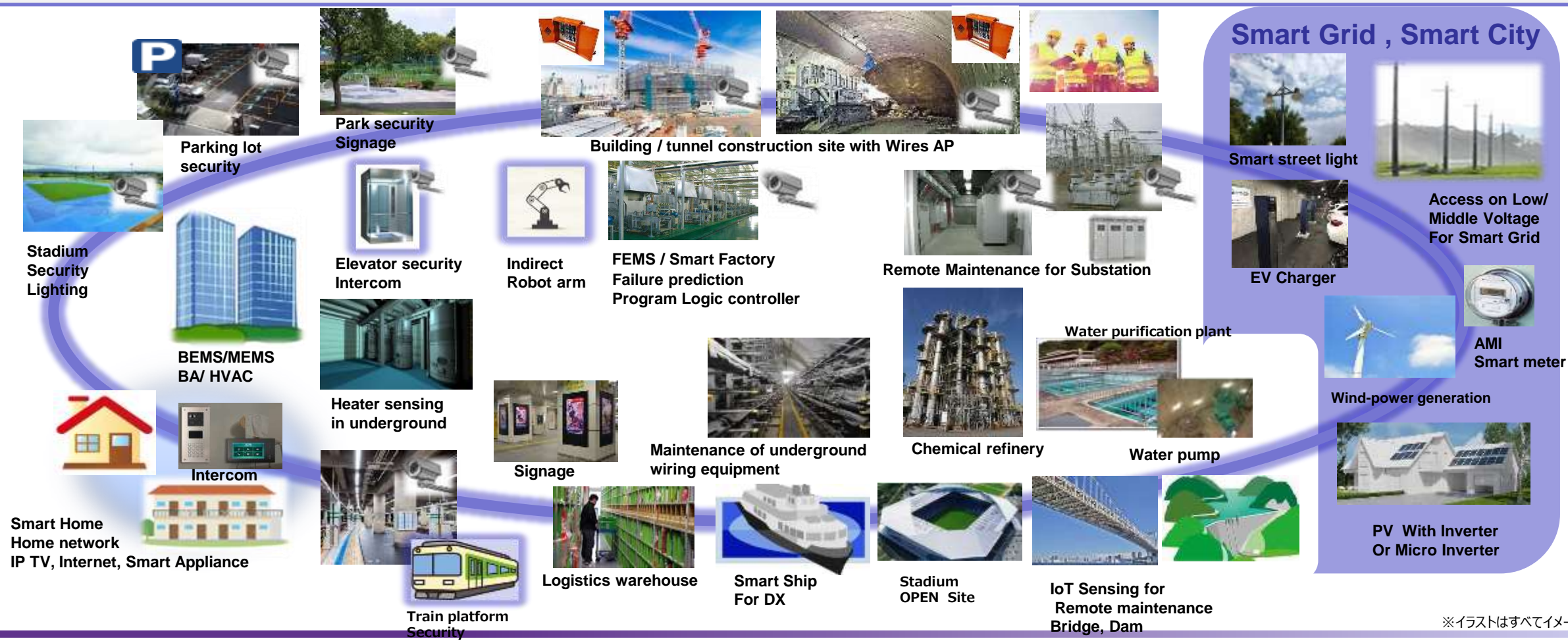
# 新たなNessus技術のご紹介



# グローバル市場の B2B IoTニーズへの導入実績、活用領域の広がり！

\* All photos and illustrations are for illustrative purposes only.

- ✓ **Nessum 第3世代チップ**: 宅内向け1ホップ版、マルチホップ（中継機能）版による長距離化の2種類
- ✓ 住宅系から非住宅系（BA、FA、インフラ、電力、輸送分野など）のXIoT利用で幅広く利用
- ✓ 相互運用性を維持し、**電力線、通信線、同軸線利用を含めグローバル累計500万個の実装実績**



※イラストはすべてイメージです